



Marking - Engraving
Laser System

BIG SMARK
200F - 400F



 **sisma**

laser

Sisma renews its design for the new generation of laser systems for microprocessing with *fiber* technology. Increased functionality of the source allow engraving, marking and microcutting to meet the highest technical standards available. Door opens on 3 sides to facilitate access, wide work chamber (500x500 mm), maximum height of piece 530 mm (F100) and can be connected with all Sisma accessories making the system highly flexible. Awareness of the process and applicative requirements, as well as constructive features, make the **Big Smark** an innovative system simple and productive.

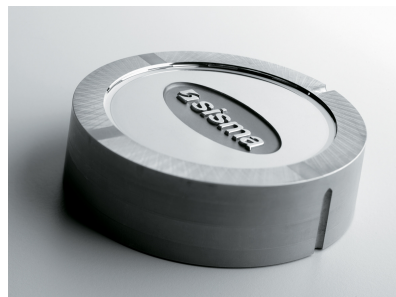
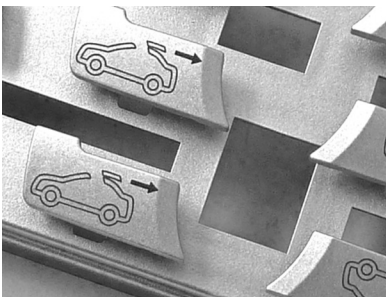
*Sisma rinnova il design per nuova generazione di sistemi laser per microlavorazioni con tecnologia in fibra. Le ampliate possibilità della sorgente permettono di eseguire processi di incisione, marcatura e microtaglio allineati con i più alti standard che stato dell'arte tecnologico permette. Apertura porta su 3 lati per un accesso facilitato, ampia camera di lavoro (500x500 mm), altezza massima del pezzo 530 mm (F100) e possibilità di connessione con tutti gli accessori Sisma rendono il sistema estremamente flessibile. La conoscenza del processo e delle necessità applicative abbinate alle caratteristiche costruttive fanno del **Big Smark** un sistema innovativo per semplicità e produttività.*



TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	BIG SMARK 200F - 400F
Output power	Potenza d'uscita	20W - 40W
Wave lenght	Lunghezza d'onda	1064 nm
Focal	Focali	F100, F163 (std), F254 mm
Power supply	Alimentazione	230V, 50/60 Hz 1ph
Cooling system	Raffreddamento	Air
Working area	Camera di lavoro	500x500x380 h mm
Dimensions	Dimensioni	550x900x1710 h mm
Net Weight	Peso netto	240 Kg

Control:	Windows PC with PCI board, RS232 Software SLC
Interface:	PLC, data network (ethernet), digital I/O
Software:	SLC software for files management marking parameters defining. Accepted extensions Svg, Dxf, Hpgl, Bmp, Jpg, Plt; control system for axis and camera for object centering, positioning and programming engraving cycles. Entirely developed in Sisma.
Options:	High precision rotary axis, dragging system with winder, dynamic measuring device, fumes aspirator, static clamping device

Controllo:	PC Windows con scheda PCI, RS232 Software SLC
Interfaccia:	PLC, rete dati (ethernet), I/O digitali
Software:	SLC per controllo parametri di marcatura ed elaborazione files Svg, Dxf, Hpgl, Bmp, Jpg, Plt; controllo assi e telecamera per centraggio, posizionamento e programmazione cicli di lavoro. Interamente sviluppato in Sisma
Opzioni:	Mandrino rotante ad alta precisione, traino guida lastra, tastatore dinamico, impianto aspirafumi, morsa statica bloccaggio pezzi



COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =

